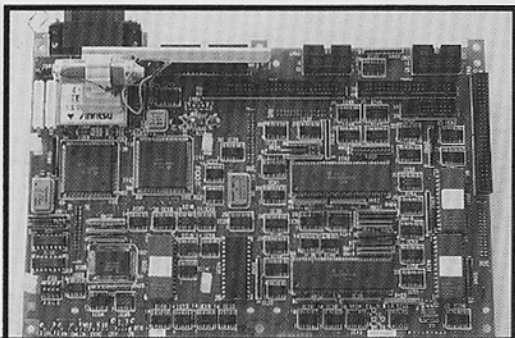


本製品は、プリント基板のハンダ付け工程前に行う銅線部の錆（さび）防止膜として使用する溶液である。この溶液は、従来の製品と違って有機溶剤ではないので防暴露設備が不要なこと、作業は一工程で済み、フロンを使わなくても済むのが特徴で、耐熱性も従来品よりもぐんと向上している。（写真はドーコートH使用のSMT）



水溶液タイプSMT用
プリフラックス「ドーコートH」